

# BUNGARD CCD SERIE BOHR- UND FRÄSANLAGEN



	CCD/2-ECO	CCD/2/MTC	CCD/2/ATC	CCD/2/ATC Precision	CCD/MTC	CCD/ATC	CCD/MTC/XL	CCD/ATC/XL	CCD PREMIUM
<b>Gewicht kg</b>	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	35 kg	35 kg	49 kg	49 kg	80 kg
<b>Abmessungen (LxBxH) mm</b>	700 x 550 x 300	700 x 550 x 300	700 x 550 x 300	700 x 550 x 300	700 x 800 x 300	700 x 800 x 300	950 x 950 x 300	950 x 950 x 300	700 x 850 x 600
<b>Arbeitsbereich mm</b>	270 x 325 x 38	270 x 325 x 38	270 x 325 x 38	270 x 325 x 38	325 x 495 x 38	325 x 495 x 38	500 x 600 x 38	500 x 600 x 38	400 x 500 x 60
<b>Werkzeugwechsel semiautom./von Hand/ 99 Werkzeuge vollautomatisch mit Längscheck</b>	ja nicht nachrüstbar	ja nicht nachrüstbar	ja ja, 16 Werkzeuge	ja ja, 16 Werkzeuge	ja nachrüstbar	ja ja, 16 Werkzeuge	ja nachrüstbar	ja ja, 25 Werkzeuge	ja ja, 30 Werkzeuge
<b>Fräsen/Bohren von 1- &amp; 2-lagigen Leiterplatten</b>	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
<b>Fräsen/Bohren HF+ Mikrowelle</b>	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆☆
<b>Fräsen/Bohren von Multilayern bis 16 Lagen *</b>	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
<b>Konturfräsen von Leiterplatten</b>	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
<b>Fräsen flexibler &amp; starrflexibler Leiterplatten **</b>	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
<b>Gravieren von Frontplatten und Schildern</b>	☆	☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆
<b>Frontplatten und Gehäusebearbeitung</b>	☆	☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆
<b>Fräsen von SMD Lotpastenschablonen und Lötrahmen</b>	☆	☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆
<b>Laserdirektbelichtung</b>	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆☆
<b>Nutzentrennung, Nachbearbeitung von Leiterplatten</b>	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
<b>Bohren von Testadaptern</b>	☆	☆	☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
<b>Kühlung</b>	☆	☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆

\*) wir empfehlen generell: wenigstens die Innenlagen von Multilayern zu ätzen  
 \*\*) für flexible Materialien bietet sich eine optionale Vakuumfixierung an

☆☆☆ gut geeignet    ☆☆☆ sehr gut geeignet    ☆☆☆ hervorragend geeignet